

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Контакт FE****Функциональная надежность — полностью интегрированная либо простая установка**

Дополнительное подключение "CH20M FE" может защитить Вашу систему благодаря контакту с монтажной рейкой для функционального заземления.

- Контакт функционального заземления предварительно собран в 6 мм корпусе, что позволяет постоянно надежное подключение электронных экранов для схем электроники к монтажной рейке (напр., "CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1 164650000)
- Функциональный контакт заземления, который может быть обработан полностью автоматически при помощи метода оплавления совместно с штыревыми соединителями и дополнительным контактом с шиной, применяется для корпусов размера от 12,5 до 67,5 мм. Положение печатной платы в корпусе определяет длину вывода 1,5 мм/3,2 мм

Общие данные заказа

Тип	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Номер для заказа	1189370000
Исполнение	Корпуса для электроники, Аксессуар, Соединение THT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 1, Длина контактного штифта (!): 1.5 mm, луженые, Таре
GTIN (EAN)	4032248972715
Норма упаковки (VPE)	750 Шт.
Продуктное отношение	UL:
Упаковка	Tape

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,482 g
-------------	---------

Данные о материалах

Поверхность контакта	луженые
----------------------	---------

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Примечания

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Технические данные	STEP

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.